

本校案號：06B-160401
(由產學合作總中心填寫)

國立臺灣大學 研究成果教師自行申請專利報備表 2015.05.06 版

計畫合作機構	科技部(合作企業:台積電) (請填寫本申請案所屬之經費來源,如:科技部、經濟部、農委會等)	<input type="checkbox"/> 利用本校資源 (勾選本項則無需填計畫名稱及編號)
計畫名稱及編號	前瞻技術產學合作計畫-7-5mm 半導體技術節點研究(2/5) MOST 103-2622-E-002 -031 - (請附計畫經費核定清單或契約書影本)	
計畫合作期限及金額	自 103 年 08 月 01 日至 104 年 07 月 31 日(延長半年) 新台幣 伍仟玖佰玖拾貳萬貳仟 元整	
申請專利名稱	Self-focused ion beam lithography using dielectric lens	
擬申請之國家	<input checked="" type="checkbox"/> 中華民國 <input checked="" type="checkbox"/> 美國 <input type="checkbox"/> 其他: <u>中國、韓國、德國</u>	
自行申請專利理由	依台大-台積電產學合作契約第四條第二項,本成果為台大、台積電共有(6:4);同條第六項規定由合作企業代為提出申請 ※請於完成專利申請程序後主動提供專利申請書、說明書、專利申請日及申請號等。	
專利管理	<input type="checkbox"/> 已委任_____ (請填寫事務所名稱)撰稿、管理 <input type="checkbox"/> 未託管事務所,由實驗室團隊撰稿、管理 <input type="checkbox"/> 其他_____	
附件	<input checked="" type="checkbox"/> *國立臺灣大學研究成果專利發明人資料表(附件一) <input checked="" type="checkbox"/> *國立臺灣大學教師自行申請專利合約(附件四) <input checked="" type="checkbox"/> 計畫經費核定清單(科技部/國科會計畫者) <input type="checkbox"/> 研究計畫補助合約書影本(非科技部/國科會計畫者)	
提案人:	<u>陳敏璋</u> 陳敏璋(簽章)	單位:台積電中心(材料系)
提案日期:	104年9月22日	職稱:教授
敬 陳		
系主任	<u>李嗣涇</u> 主任	
院 長		

研發處(產學合作總中心)

擬依自行申請專利報備程序辦理

研發長

本案奉核後,請文書組於附件四合約書乙式兩份用學校大小印後送回產學中心

證琨榮單位補充、修正內容後,於105.04.28送抵本中心。
研產學合作總中心 智權管理師 陳慧蘭 105.04.29.

附件一、國立臺灣大學研究成果專利發明人資料表

<p>※發明人欄位填寫說明：</p> <p>(1)發明人超過三位時，請自行複製發明人欄位使用。</p> <p>(2)發明人請填寫實際的發明人，參酌美國專利實務上的認定，所謂發明人必須是對發明概念之形成及至少一項申請專利範圍之標的有所貢獻之人，才能稱為發明人。美國專利法規定，若列名之發明人未有發明之事實，則不得取得專利；若發明人記載錯誤，且可證明有「欺瞞之意圖」，則此專利權無法主張權利（單純接受指示，依所設計之實驗完成實驗結果者、提出需求者、提出產品缺點者等無實質貢獻者，不能算是發明人）。</p> <p>(3)未來收益分配之有功人員不限於此專利申請案所列之實際發明人。</p>						
發明人	1	姓名	(中文/英文) 陳敏璋/ Chen, Miin-Jang			
		服務單位	國立臺灣大學/材料系	職稱	教授	
		國籍	<input checked="" type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____	身份證字號 或護照字號	E120626185	
		e-mail	mjchen@ntu.edu.tw	電話	02-3366-5301	
		聯絡地址	台北市中正區林興里 12 鄰水源路 43 號 3 樓			
	2	姓名	(中文/英文)			
		服務單位		職稱		
		國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____	身份證字號 或護照字號		
		e-mail		電話		
		聯絡地址				
	3	姓名	(中文/英文)			
		服務單位		職稱		
		國籍	<input type="checkbox"/> 中華民國 <input type="checkbox"/> 其他：_____	身份證字號 或護照字號		
		e-mail		電話		
		聯絡地址				

附件二、技術推廣表(含以下兩頁之中、英文表單)

為協助技術移轉，是否有意願與本中心合作推廣本技術[※]？

是(本中心將於技術交易網或各媒合會上發佈此資料)；

否(原因_____；若有意願使用本技術衍生新創公司者，可勾否)。

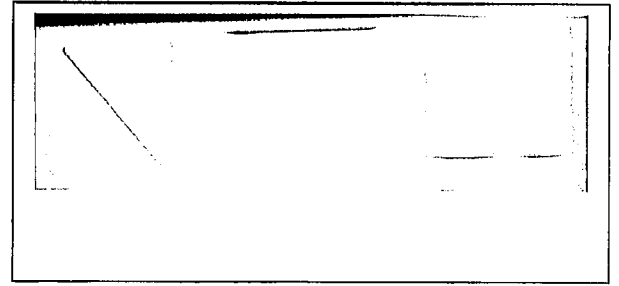
※依專利法第七條規定，提案人之各專利案的專利申請權及專利權，皆屬本校所有。



使用介電層自聚焦式之離子束微影技術

發明人： 陳敏璋 教授
單位： 國立臺灣大學 材料系
簡歷：

http://www.mse.ntu.edu.tw/index.php?option=com_zoo&task=detail&Itemid=902&lang=tw



市場及需求：未來尖端奈米科技需要小於 10 奈米的微縮製程

技術摘要(含成果)：能大範圍的做出小於 10 奈米的圖形

優勢：避開一般傳統光學系統所遇到的困難，以達到小於 10 奈米的微縮能力

競爭產品：EUV He beam lithography

專利現況：美國已有申請專利

Filing to PTO; filing date 9/14/2015 and accorded No 14/852,818

聯絡方式(請不用填)：

臺大產學合作總中心

Tel: 02-3366-9945, E-mail: ntuciac@ntu.edu.tw



Self-focused ion beam lithography using dielectric lens

PI : Prof. Miin-Jang Chen

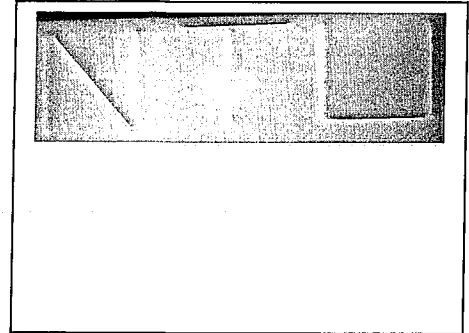
Department of Materials Science and Engineering,
National Taiwan U.

Experience:

http://www.mse.ntu.edu.tw/index.php?option=com_zoo&task=item&item_id=47&Itemid=902&lang=tw

Market Needs:

Future nano technology requires next generation sub-5 nm lithography



Our Technology:

Fabrication of large area sub-5nm nano patterns

Strength:

Resolve the resolution problems of the conventional lithography in regard to sub-5nm lithography.

Competing Products:

EUV, He ion lithography

Intellectual Properties:

USA

Filing to PTO; filing date 9/14/2015 and accorded No 14/852,818

Contact (do not need to fill out):

Center for Industry-Academia Cooperation, NTU

Tel: 02-3366-9945, E-mail: ntuciac@ntu.edu.tw

This information herein is intended for potential license of NTU technology only. Other usage of all or portion of this information in whatever form or means is strictly prohibited. Kindly contact us and we will help to achieve your goal the best we can.

附件三、技術分類表

(請依技術本質勾選(可複選)或於其他(請自填)欄位填入適當類別；分類結果將置於網頁)

一階	二階	三階
生醫農健	農業	<input type="checkbox"/> 植物種苗 <input type="checkbox"/> 動物種苗 <input type="checkbox"/> 生物農藥 <input type="checkbox"/> 生物肥料 <input type="checkbox"/> 抗病/蟲/逆境性 <input type="checkbox"/> 生物整治 <input type="checkbox"/> 品種權 <input type="checkbox"/> 生物機電 <input type="checkbox"/> 組織培養 <input type="checkbox"/> 觀賞 <input type="checkbox"/> 發酵 <input type="checkbox"/> 基因轉殖 <input type="checkbox"/> 糧食 <input type="checkbox"/> 蔬菜 <input type="checkbox"/> 天然物利用 <input type="checkbox"/> 遺傳育種 <input type="checkbox"/> 森林學 <input type="checkbox"/> 獸醫學 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	醫療器材	<input type="checkbox"/> 診斷與監測用器材 <input type="checkbox"/> 體外診斷用器材 <input type="checkbox"/> 手術與治療用器材 <input type="checkbox"/> 輔助與彌補用器材其他類醫療器材 <input type="checkbox"/> 疼痛管理器材 <input type="checkbox"/> 低/非侵入性器材 <input type="checkbox"/> 預防疾病與健康促進之設備及用品 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	篩選平台	<input type="checkbox"/> 抗體 <input type="checkbox"/> 生物晶片 <input type="checkbox"/> 細胞分析 <input type="checkbox"/> 組合式分子生物 <input type="checkbox"/> 組合化學 <input type="checkbox"/> 高通量藥物篩選技術(HITS)噬菌體展示技術 <input type="checkbox"/> 蛋白酶 <input type="checkbox"/> 藥物篩選 <input type="checkbox"/> 標靶藥物 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	藥物	<input type="checkbox"/> 止痛藥 <input type="checkbox"/> 麻醉劑 <input type="checkbox"/> 血管生成 <input type="checkbox"/> 消炎 <input type="checkbox"/> 抗生素 <input type="checkbox"/> 抗體 <input type="checkbox"/> 抗癌 <input type="checkbox"/> 抗真菌 <input type="checkbox"/> antisense <input type="checkbox"/> 抗病毒 <input type="checkbox"/> 細胞凋亡 <input type="checkbox"/> 細胞訊息 <input type="checkbox"/> 中樞神經系統 <input type="checkbox"/> 疾病模型 <input type="checkbox"/> 藥物輸送 <input type="checkbox"/> 生育 <input type="checkbox"/> 基因治療 <input type="checkbox"/> 賀爾蒙 <input type="checkbox"/> 免疫治療 <input type="checkbox"/> 發炎 <input type="checkbox"/> 新陳代謝 <input type="checkbox"/> 天然物 <input type="checkbox"/> 病原體 <input type="checkbox"/> 胜肽 <input type="checkbox"/> 前驅藥物 <input type="checkbox"/> 蛋白質 <input type="checkbox"/> RNAi <input type="checkbox"/> 小分子藥物幹細胞 <input type="checkbox"/> 疫苗 <input type="checkbox"/> 病毒 <input type="checkbox"/> 傷口癒合 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	基因體學	<input type="checkbox"/> allele <input type="checkbox"/> 生物資訊學 <input type="checkbox"/> cDNA <input type="checkbox"/> DNA <input type="checkbox"/> 流行病學 <input type="checkbox"/> EST <input type="checkbox"/> 基因 <input type="checkbox"/> 基因型 <input type="checkbox"/> homologue <input type="checkbox"/> isogene <input type="checkbox"/> 基因庫 <input type="checkbox"/> 微陣列/微陣列分析軟體 <input type="checkbox"/> 藥物基因體學 <input type="checkbox"/> 聚合酶 <input type="checkbox"/> 多型性 <input type="checkbox"/> 定位選殖 <input type="checkbox"/> 蛋白質體學 <input type="checkbox"/> 受體 <input type="checkbox"/> RNA <input type="checkbox"/> 標靶驗證 <input type="checkbox"/> 基因轉殖動物 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	研究工具	<input type="checkbox"/> 抗體 <input type="checkbox"/> 細胞株 <input type="checkbox"/> 色層分析 <input type="checkbox"/> 細胞培養 <input type="checkbox"/> 定向分子演化 <input type="checkbox"/> DNA / RNA 定序 <input type="checkbox"/> DNA / RNA 合成 <input type="checkbox"/> 電泳 <input type="checkbox"/> 酵素 <input type="checkbox"/> 裝置 <input type="checkbox"/> 表現系統 <input type="checkbox"/> 雜交 <input type="checkbox"/> 老鼠模式 <input type="checkbox"/> 寡核苷酸合成 <input type="checkbox"/> PCR 檢測 <input type="checkbox"/> 蛋白酶 <input type="checkbox"/> 蛋白質定序 <input type="checkbox"/> 蛋白質合成 <input type="checkbox"/> 試劑 <input type="checkbox"/> RNAi <input type="checkbox"/> 光譜 <input type="checkbox"/> 載體 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	技術	<input type="checkbox"/> 抗體 <input type="checkbox"/> 生物晶片 <input type="checkbox"/> 顯影劑 <input type="checkbox"/> DNA 探針 <input type="checkbox"/> 造影成像 <input type="checkbox"/> 分子標記 <input type="checkbox"/> 放射性同位素 <input type="checkbox"/> 檢測技術 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
電資通光	電子光電	<input type="checkbox"/> 光資訊技術 <input checked="" type="checkbox"/> 光電半導體技術 <input type="checkbox"/> 平面顯示技術 <input type="checkbox"/> 背光技術 <input type="checkbox"/> 軟性電子技術 <input type="checkbox"/> 光學技術(含鏡片材料) <input type="checkbox"/> 電子及光電構裝技術 <input type="checkbox"/> 矽基半導體技術 <input type="checkbox"/> 電磁/光電訊號檢測 <input checked="" type="checkbox"/> 奈米電子技術 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	資訊通訊	<input type="checkbox"/> 有線網路 <input type="checkbox"/> 語音 <input type="checkbox"/> 資訊安全 <input type="checkbox"/> 監控 <input type="checkbox"/> 網際網路電話相關技術(VoIP) <input type="checkbox"/> Web 相關技術 <input type="checkbox"/> 智慧型資訊系統 <input type="checkbox"/> 無線通訊技術 <input type="checkbox"/> 射頻辨識技術及應用(RFID) <input type="checkbox"/> 環境控制與感知技術 <input type="checkbox"/> 數位視/音訊與多媒體技術 <input type="checkbox"/> 光通訊技術 <input type="checkbox"/> 電子商務 <input type="checkbox"/> 嵌入式系統技術 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	材料化工	<input type="checkbox"/> 添加劑 <input type="checkbox"/> 觸媒 <input type="checkbox"/> 塗料/塗佈 <input type="checkbox"/> 電化學 <input type="checkbox"/> 石墨烯 <input type="checkbox"/> 導電高分子 <input type="checkbox"/> 塑料/聚合/複合材料 <input type="checkbox"/> 化學/生物分析 <input type="checkbox"/> 奈米材料 <input type="checkbox"/> 半導體材料/製程 <input type="checkbox"/> 物料改質 <input type="checkbox"/> 超導體 <input type="checkbox"/> 分散均勻化 <input type="checkbox"/> 光學薄膜 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
機能材化	能源環工	<input type="checkbox"/> 替代/生質能源 <input type="checkbox"/> 燃料電池 <input type="checkbox"/> 化學/生物分析 <input type="checkbox"/> 高電功率 <input type="checkbox"/> 碳氫化合物 <input type="checkbox"/> 儲能 <input type="checkbox"/> 節能減碳 <input type="checkbox"/> 太陽能/電池 <input type="checkbox"/> 海洋工程 <input type="checkbox"/> 醫學/診斷/器械/儀器 <input type="checkbox"/> 環境整治 <input type="checkbox"/> 土木工程 <input type="checkbox"/> 水利工程 <input type="checkbox"/> 感測/量測方法/系統 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
	機械儀設	<input type="checkbox"/> 機械元件/裝置/設備 <input type="checkbox"/> 分析儀器 <input type="checkbox"/> 光學/激光機器人 <input type="checkbox"/> 顯微技術 <input type="checkbox"/> 導航(GPS) <input type="checkbox"/> 光譜儀 <input type="checkbox"/> 超音波 <input type="checkbox"/> 電腦輔助設計/檢測 <input type="checkbox"/> 圖像處理 <input type="checkbox"/> 環境感測/感應器 <input type="checkbox"/> 生理訊號感測 <input type="checkbox"/> 致動器 <input type="checkbox"/> 微機電/元件/系統 <input type="checkbox"/> 微控制 <input type="checkbox"/> 其他(請自填)
其他(請自填)		

附件四、國立臺灣大學教師自行申請專利合約書

本校案號：06B-160401
(由產學合作總中心填寫)

立合約書人：國立臺灣大學（以下簡稱甲方）
陳敏璋（以下簡稱乙方）

乙方執行科技部(合作企業:台積電)補助專題研究計畫前瞻技術產學合作計畫「7-5nm 半導體技術節點研究(2/5)」(計畫編號: MOST 103-2622-E-002 -031 -)之研發成果「Self-focused ion beam lithography using dielectric lens」, 其智慧財產權屬甲方及台積電共有, 惟乙方經甲方同意, 得自行依各國專利法申請專利, 約定下列條款, 依誠實信用原則共同遵守:

- 一、乙方將研發成果「Sub-10 nm lithography」先行自費辦理專利申請及維護事宜。乙方自行申請專利時, 其專利申請相關費用、技術移轉(或授權)、權益分配及其他相關事宜, 應由甲方統籌依「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」及其他相關法令規定辦理, 乙方應負協助之義務。
- 二、乙方對專利申請或專利權維護及利用應盡善良管理人之義務, 未經甲方事前書面同意, 不得逕行終止專利申請或專利維護案, 亦不得逕行將專利申請權或專利權授權他人利用, 或為任何信託、讓與、設定負擔或其他損及甲方權益之行為。

乙方不願繼續申請或維護專利權時, 應事先以書面通知甲方, 並由甲方依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點及其他相關法令規定辦理。

- 三、甲方得視需要要求乙方將專利申請權(或專利權)無條件讓與甲方, 並應於接獲甲方通知後, 於甲方指定期限內配合辦理權利讓與事宜, 且不得另行要求任何報酬。

乙方將前項專利申請權(或專利權)讓與完成後, 並經甲方審議通過認為有必要繼續申請或維護者, 得依國立臺灣大學技術移轉業務獎助金與專利及技術移轉個案獎勵金運用分配準則核給乙方發明專利獎勵金。

- 四、乙方如違反本合約第一點、第二點、第三點與第五點之約定, 除應承擔一切法律責任外, 甲方並得視情節輕重要求損害賠償。

- 五、本合約有效期至依第一點取得之專利權期限屆滿為止, 但乙方因本合約第四點所負之責任與義務不因本合約終止而解除。於本合約有效期間內, 乙方應對本合約內容保守秘密, 不得任意向第三人揭露。乙方因本合約自行

申請而取得多數國家或地區專利者，本合約存續至最後一項專利權期限屆滿為止。

六、本合約未約定事項，適用民法及其他法令相關規定。本合約部分條款如因故無效或無法履行，不影響其他條款之效力。

七、就本合約所生之爭議糾紛，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

八、本合約正本一式二份，雙方各執存一份。

立合約書人

甲 方：國立臺灣大學 (簽章)

代 表 人：楊泮池

地 址：10617 臺北市大安區羅斯福路四段一號

陳敏璋  (簽章)

任職單位：國立臺灣大學/材料系

地 址：台北市中正區林興里 12 鄰水源路 43 號 3 樓

中華民國 104 年 9 月 22 日

附件四、國立臺灣大學教師自行申請專利合約書

本校案號：06B-16040/
(由產學合作總中心填寫)

立合約書人：國立臺灣大學（以下簡稱甲方）
陳敏璋（以下簡稱乙方）

乙方執行科技部(合作企業:台積電)補助專題研究計畫前瞻技術產學合作計畫—7-5mm 半導體技術節點研究(2/5)」（計畫編號：MOST 103-2622-E-002 -031 -）之研發成果「Self-focused ion beam lithography using dielectric lens」，其智慧財產權屬甲方及台積電共有，惟乙方經甲方同意，得自行依各國專利法申請專利，約定下列條款，依誠實信用原則共同遵守：

- 一、乙方將研發成果「Sub-10 nm lithography」先行自費辦理專利申請及維護事宜。乙方自行申請專利時，其專利申請相關費用、技術移轉（或授權）、權益分配及其他相關事宜，應由甲方統籌依「科學技術基本法」、「政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法」、「國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點」及其他相關法令規定辦理，乙方應負協助之義務。
- 二、乙方對專利申請或專利權維護及利用應盡善良管理人之義務，未經甲方事前書面同意，不得逕行終止專利申請或專利維護案，亦不得逕行將專利申請權或專利權授權他人利用，或為任何信託、讓與、設定負擔或其他損及甲方權益之行為。

乙方不願繼續申請或維護專利權時，應事先以書面通知甲方，並由甲方依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法、國立臺灣大學研究發展成果及技術移轉管理要點及其他相關法令規定辦理。

- 三、甲方得視需要要求乙方將專利申請權（或專利權）無條件讓與甲方，並應於接獲甲方通知後，於甲方指定期限內配合辦理權利讓與事宜，且不得另行要求任何報酬。

乙方將前項專利申請權（或專利權）讓與完成後，並經甲方審議通過認為有必要繼續申請或維護者，得依國立臺灣大學技術移轉業務獎助金與專利及技術移轉個案獎勵金運用分配準則核給乙方發明專利獎勵金。

- 四、乙方如違反本合約第一點、第二點、第三點與第五點之約定，除應承擔一切法律責任外，甲方並得視情節輕重要求損害賠償。

- 五、本合約有效期至依第一點取得之專利權期限屆滿為止，但乙方因本合約第四點所負之責任與義務不因本合約終止而解除。於本合約有效期間內，乙方應對本合約內容保守秘密，不得任意向第三人揭露。乙方因本合約自行

申請而取得多數國家或地區專利者，本合約存續至最後一項專利權期限屆滿為止。

六、本合約未約定事項，適用民法及其他法令相關規定。本合約部分條款如因故無效或無法履行，不影響其他條款之效力。

七、就本合約所生之爭議糾紛，雙方同意以台北地方法院為第一審管轄法院。

八、本合約正本一式二份，雙方各執存一份。

立合約書人

甲 方：國立臺灣大學 (簽章)

代 表 人：楊泮池

地 址：10617 臺北市大安區羅斯福路四段一號

陳敏璋 (簽章)

任職單位：國立臺灣大學/材料系

地 址：台北市中正區林興里 12 鄰水源路 43 號 3 樓

中華民國 104 年 9 月 22 日

103年度【前瞻技術產學合作計畫—7-5nm半導體技術節點研究(2/5)】經費核定清單

執行機構：	國立臺灣大學 財團法人國家同步輻射研究中心 國立臺灣大學	主持人：	李嗣涔	教授(電子工程學研究所)
		共同主持人：	皮敦文	研究員(物理學系暨研究所)
			梁洪銘	教授(物理學系暨研究所)
			白偉鴻	教授(凝態科學研究中心)
			鄭張陸	教授(土木水利工程學暨研究所)
			李峻斯	助理教授(電機工程學暨研究所)
			郭坤	助理教授(電機工程學暨研究所)
			蔡振宏	教授(材料科學工程學暨研究所)
			高敏璋	教授(材料科學工程學暨研究所)
			陳明	教授(電子工程學研究所)
			毛敏	教授(電子工程學研究所)
			劉敏	教授(電子工程學研究所)
			林浩	教授(電子工程學研究所)
			管傑	教授(電子工程學研究所)
			李建	教授(電子工程學研究所)
			張耀	教授(電子工程學研究所)
			江宏	教授(電子工程學研究所)
			胡振	教授(電子工程學研究所)
			吳肇	教授(電子工程學研究所)
			吳志	教授(電子工程學研究所)
			吳育	教授(光電工程學研究所)
			李敏	教授(光電工程學研究所)
			郭瑞	教授(光電工程學研究所)
			張書	教授(光電工程學研究所)
			陳煜	教授(光電工程學研究所)
			臧振	教授(物理學系)
			辛裕	教授(物理學系)
			鄭秋	教授(物理學系)
			關正	教授(物理學系)
			楊量	教授(物理學系)
			林時	教授(物理學系)
			許舒	教授(物理學系)
				研究員(應用科學研究中心)
				研究員(應用科學研究中心)
				研究員(應用科學研究中心)
				研究員(應用科學研究中心)
				研究員(奈米元件實驗室)

國立臺灣師範大學
國立清華大學
國立中央大學
國立交通大學
國立中央大學
國立嘉義大學
中央研究院

合作企業：財團法人國家實驗研究院
台灣積體電路製造股份有限公司

補助項目	向科技部申請金額	科技部核定金額	合作企業配合款	說明
業務費	47,883,000	30,159,600	29,195,000	一、研究人力費：14,843,600元 1. 專任助理8名3,942,100元 2. 碩士班研究生研究助學金46名3,312,000元 3. 大專學生研究助學金12名576,000元 4. 博士班研究生獎助金3名864,000元 5. 博士班研究生獎助金24名3,456,000元 6. 博士後研究3名2,693,500元 二、耗材、物品、圖書及雜項費用：15,316,000元(含實驗中心儀器使用費) 三、本計畫彈性支用額度為25,000元 *合作企業配合款經費用途詳見合作企業明細表
研究設備費	24,815,000	24,815,000	3,985,000	氮/氬離子束直寫奈米製像機，高精度無塵室升級工程系統，III-V族磊晶系統及IV族磊晶系統，運算軟體，高效能個人電腦及週邊硬體，印表機 *合作企業配合款經費用途詳見合作企業明細表
國外差旅費	0	0	820,000	*合作企業配合款經費用途詳見合作企業明細表
管理費	7,182,000	4,947,400	6,000,000	
合計	79,880,000	59,922,000	40,000,000	執行期限：103/08/01 ~ 104/07/31 計畫編號：MOST 103-2622-E-002 -031 -

貴儀中心使用額度：6,000,000元
 研究類型：前瞻技術產學合作計畫(個別型)
 研究性質：應用研究
 應繳報告：期中完整報告及期中精簡報告(請於計畫執行期滿前三個月，至本部網站線上繳交進度報告，以憑核定
 下年度經費)
 成果歸屬：計畫執行所獲得之研發成果，屬於本部出資部分所應得者，除經本部認定歸屬本部所有者外，全部歸屬國立臺灣大學所有；屬合作企業出資部分、由國立臺灣大學與合作企業依科學技術基本法、政府科學技術研究發展成果歸屬及運用辦法及其他相關法令規定商議約定之。
 出資比例：本部出資比例：59.97%，合作企業出資比例：40.03%。

學門名稱：微電子工程
 流水號：103PBIC
 承辦人：潘敏治

合作企業派員數：10 人
各項費用之支用請依「科技部補助前瞻技術產學合作計畫試行要點及專題計畫經費處理原則」規定辦理。

* 合作企業配合款請貴校檢據逕向合作企業請款

103年度【前瞻技術產學合作計畫－7-5nm半導體技術節點研究(2/5)】合作企業明細表

補助項目	科技部	台灣積體電路製造股份有限公司
業務費	30,159,600 元	29,195,000 元 合作企業配合款21,350,000元用於研究人力費，680,000元用於國外學者來台費用，餘用於耗材、物品及雜項費用。
研究設備費	24,815,000 元	3,985,000 元 合作企業配合款用於購置氮/氙離子束直寫奈米製像機、安全警報監控通報系統。
國外差旅費	0 元	820,000 元 合作企業配合款300,000元用於國際合作與移地研究，餘用於出席國際學術會議。
管理費	4,947,400 元	6,000,000 元
合計	59,922,000 元	40,000,000 元
出資比例	59.97%	40.03%

變更前資料：
 計畫編號： MOST - - - - -
 主持人：
 職稱：()
 執行機構：()
 計畫名稱：
 學門：()
 貴儀中心使用額度：0 元